

产品说明书

TACFlux® 571HF

简介

TACFlux® 571HF 是一款免洗无卤素助焊剂,为手工焊接和返修而设计。TACFlux® 571HF与PCB组装中使用的典型的无铅(SAC)及低温的铋基和锡基合金兼容。其优势包括:

- 根据IEC-61249-2-21的EN14583测试法检测无卤素
- 回流后的残留透明,适用于免洗应用
- 保质期最长可达一年

特性

行业标准测试结果	
测试	结果
助焊剂分类	ROLO
根据IEC-61249-2-21的EN14583测试法检测无卤素	<900ppm Cl <900ppm Br <1,500ppm 总含量
典型黏度*	12.5kcps
典型粘力	135g
典型酸值	130mg KOH/G
SIR (J-STD-004B)	通过
ECM (J-STD-004B)	通过
助焊剂导致的腐蚀 铜镜)	通过
腐蚀	通过

*Brookfield Cone & Plate (CP51, 5rpm, 5分钟, 25°C).

其他测试	
测试	结果
外观	透明
最高回流温度	260°C
回流气氛	空气或氮气
保质期	一年 (0-30°C)
储存条件	在0-30°C环境下储存 筒装或注射器包装应尖头朝下

所有信息仅供参考。
不应作为所收到产品的规格说明。

本产品说明书仅供参考,并不对所描述的性能做任何担保。具体质保信息请参见产品合同、发票或者发货单里的文字说明。除特别说明,钢泰公司的产品和解决方案均市场有售。

所有钢泰公司的焊锡膏和焊片工厂均获得了 IATF 16949:2016 认证。钢泰公司是 ISO 9001:2015 认证的公司。

From One Engineer To Another®

联系我们的工程师: china@indium.com

有关详情: www.indiumchina.cn

亚洲 +65 6268 8678 • 中国 +86 (0) 512 628 34900 • 欧洲 +44 (0) 1908 580400 • 美国 +1 315 853 4900

包装

TACFlux® 571HF 可提供10cc和30cc的注射器包装或100g罐装。其他包装可应求提供。

清洗

TACFlux® 571HF 为免洗应用设计。如果需要,可用市售助焊剂清洗剂清洗。

回流

在空气或氮气回流气氛中,TACFlux® 571HF的回流峰值温度应该低于260°C。

储存

筒装或注射器包装的TACFlux® 571HF 应尖头朝下,储存在0-30°C的环境中。如果冷藏,TACFlux® 571HF 应该在使用前4小时从冷藏环境中取出。

技术支持

钢泰公司的工程师经验丰富,在全球范围内为客户提供深入的技术支持。我们的技术支持工程师精通被应用于电子和半导体行业的材料科学的各个方面,能够为预成型焊片、焊锡丝、焊锡带和焊锡膏等焊接材料提供专业建议并快速回应所有技术咨询。

安全说明书

请参考随货品一起寄出的产品安全说明书,或者联络钢泰公司当地的销售团队获取。



表格编号: 99696 (SC A4) R2



©2022钢泰公司